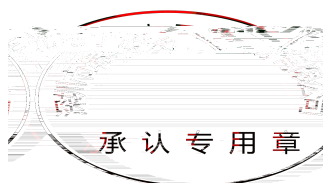


# 产品 书

产品型号

R&D 发

产供



# SHWARK

产品  
产品  
产品应  
封  
产品

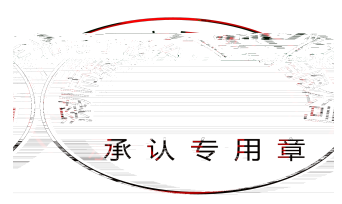
典型光学

产品包

包

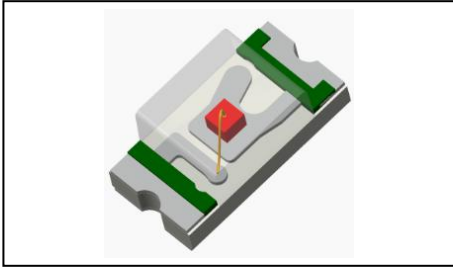
J F

带尺寸



## 产品介

### 产品



产品为 光 ， 光 封 形 ， 产品尺寸： 。

### 产品 征

发光 度大

于 SMT 和 工

Level3

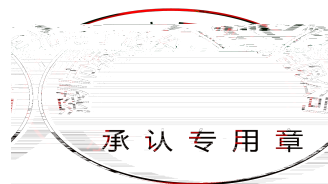
RoHS

### 产品应

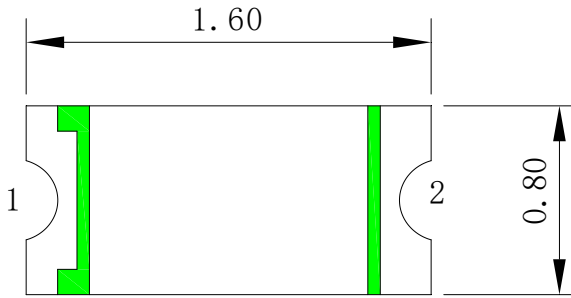
光学

开关和 志， 器

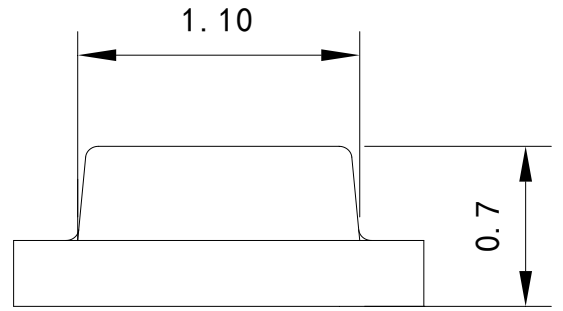
其他应



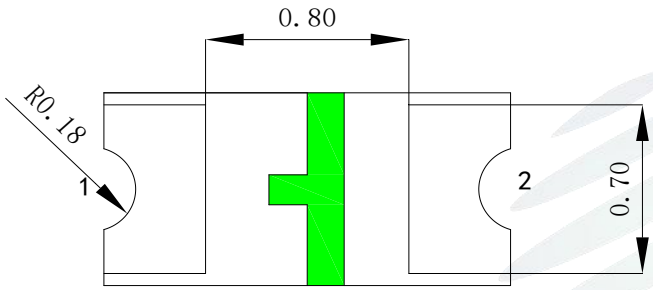
封 尺 寸



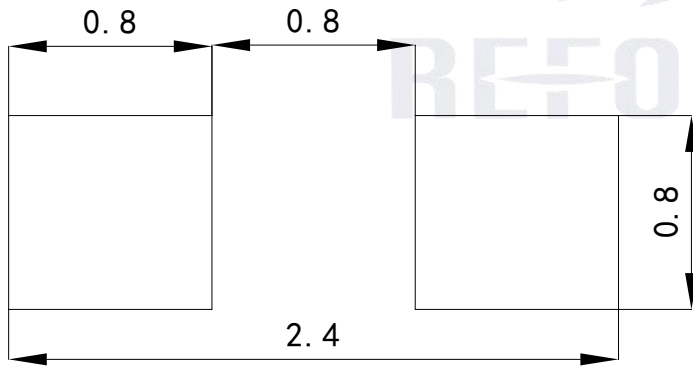
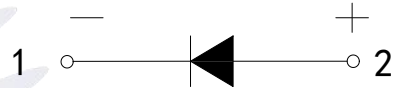
图



侧 图



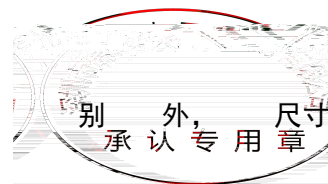
图



备 注 :

1. 尺寸 单位为

±



别 外, 尺寸公差为±0.2  
承 认 专 用 章

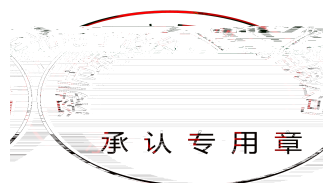
## 产品参

与光学

	件	号				单位
			小值	(典型值)	(大值)	
半宽		△				
向压						
主						
发光强度						
发光度						
						μ
						°C

备

为分件。



对 大值

备 :

宽0.1ms, 占 1/10.

以上 压 差  $\pm 0.1V$ .

以主 差  $\pm 2nm$ .

上 发光强度 允 公差为  $\pm 10\%$ .

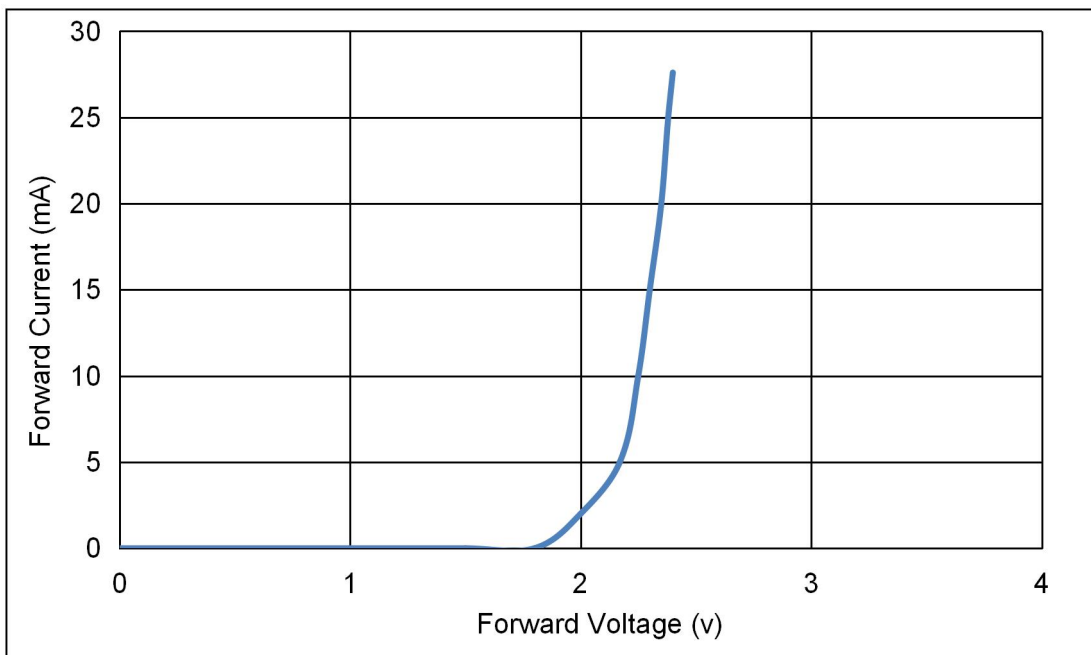
使

功 不 定 大值。

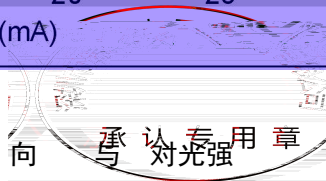
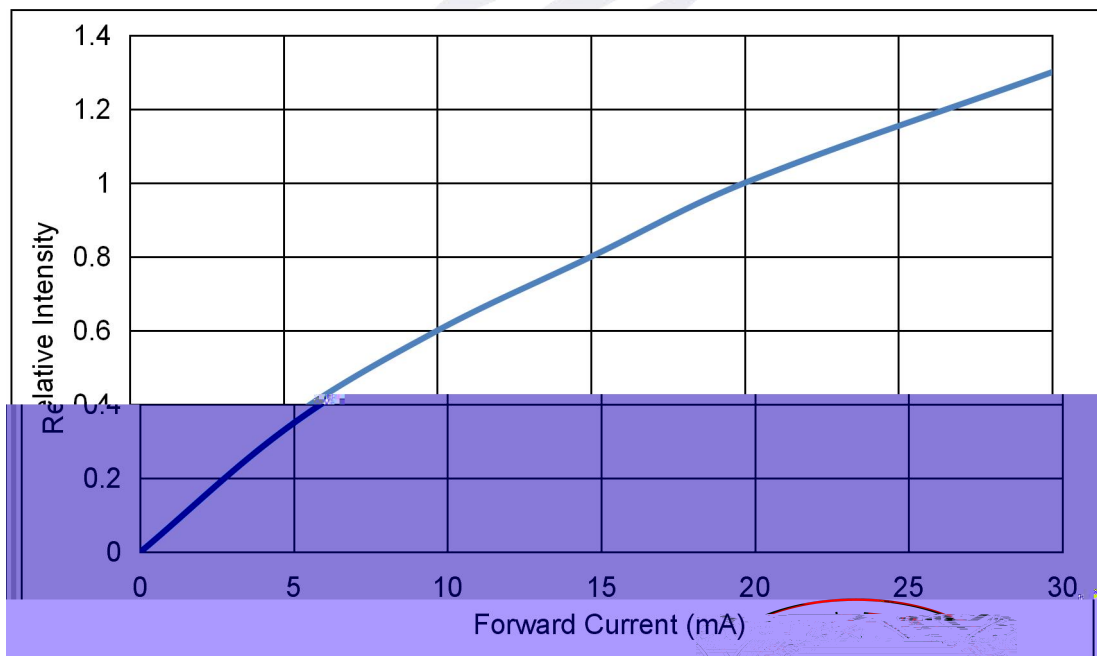
基于 丰

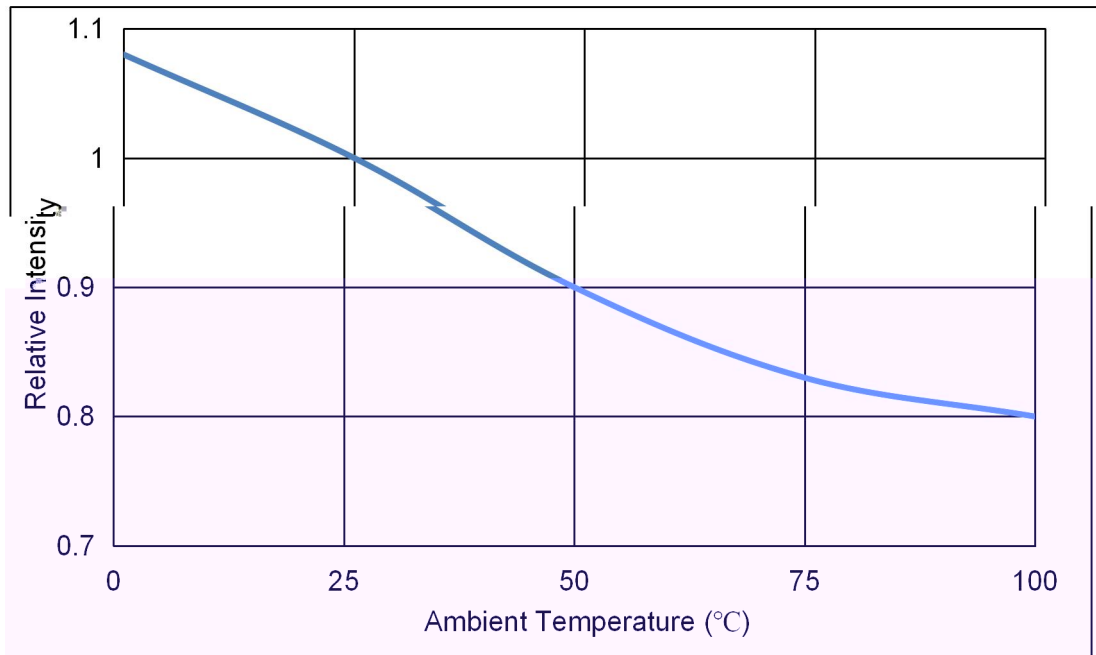
准 平台。

### 典型光学

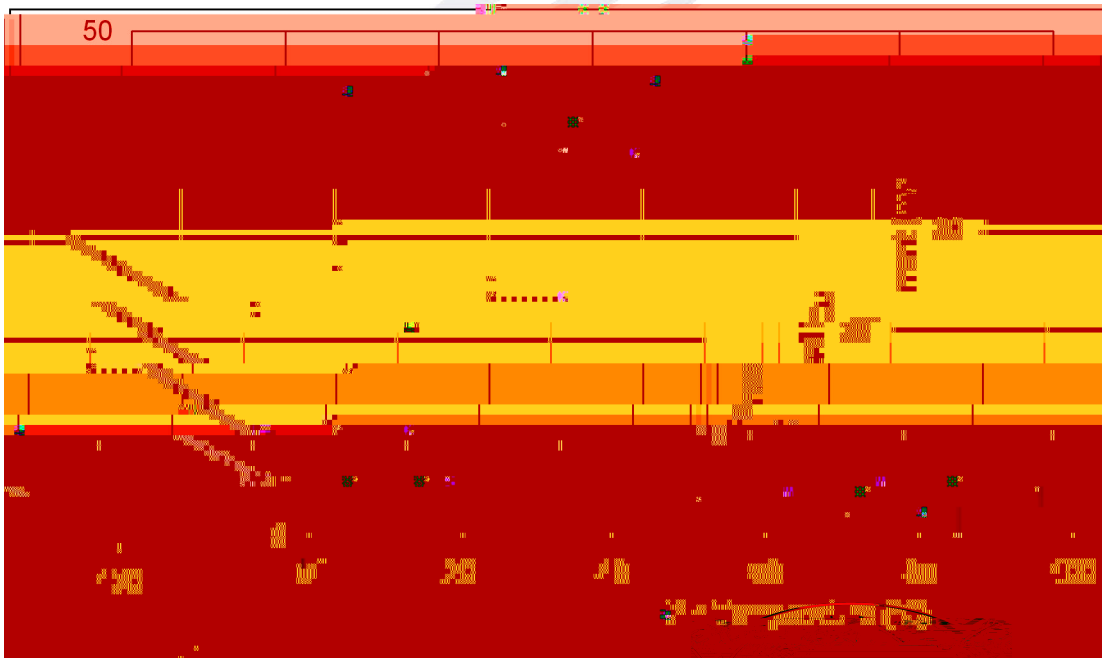


伏安

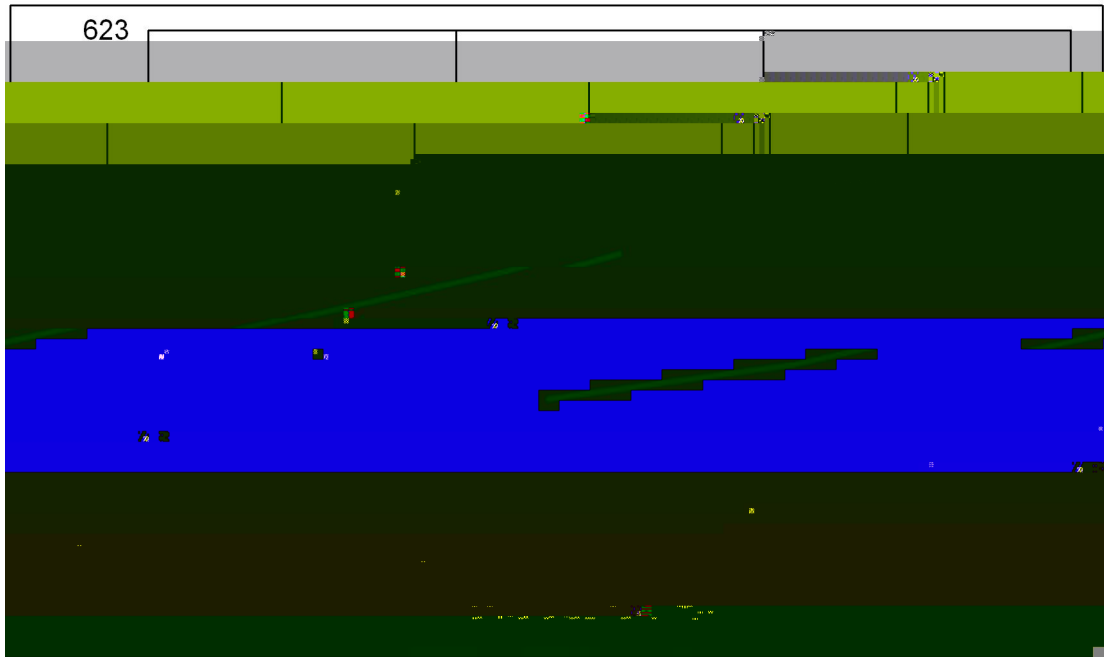




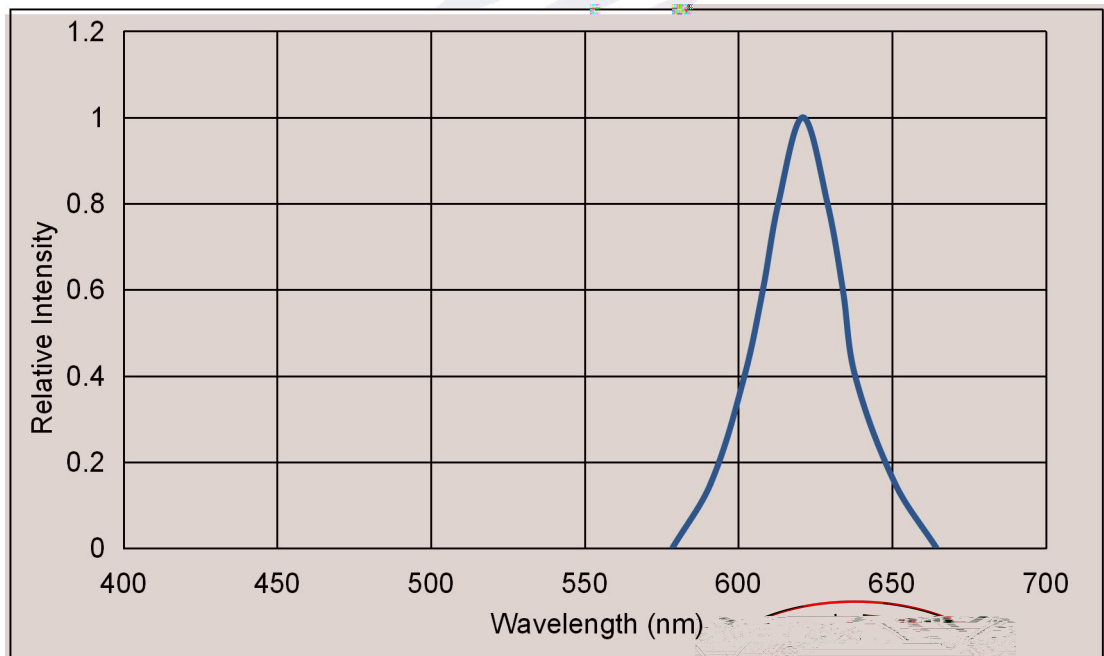
引 度与 对光强



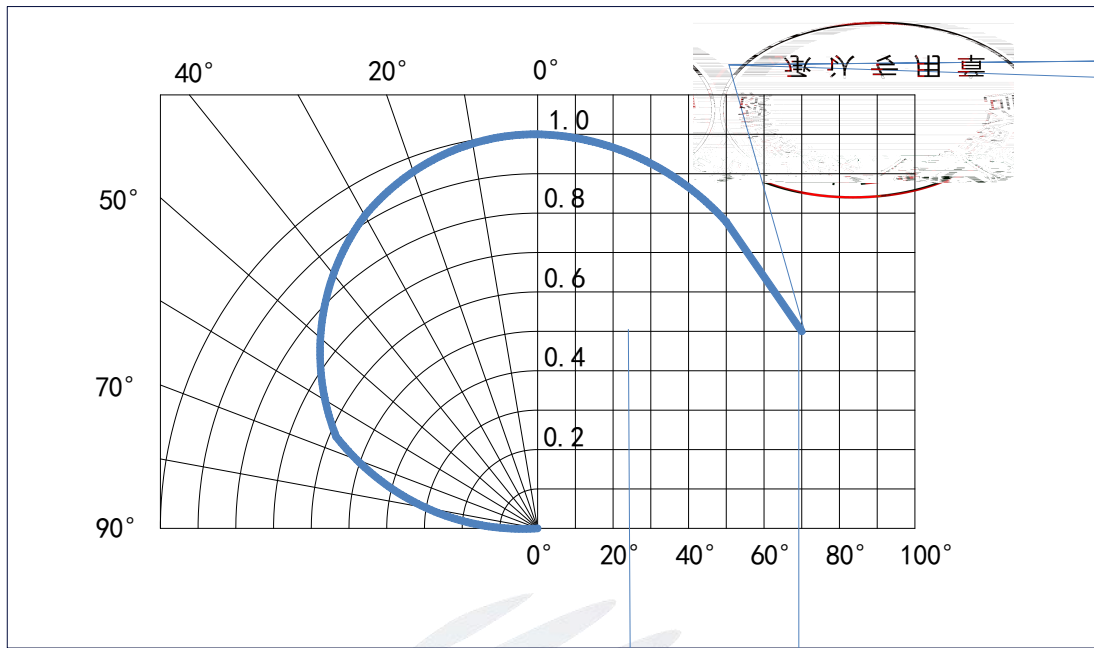
引 度咏 谏专用章



°C 向 与 主 关



°C 对 承 强 与 专 用 章

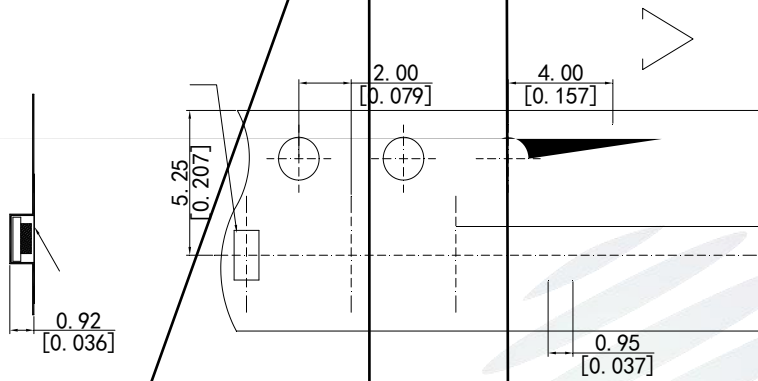


射

REFOND

产品包

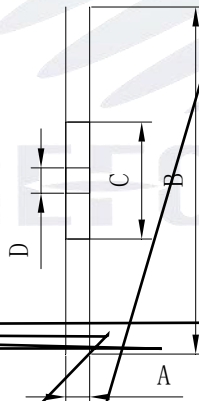
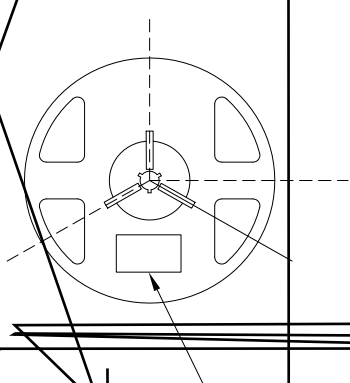
包  
卷  
带尺寸



带尺寸

卷尺寸

尺寸





	±
	±
	±
	±

标签

卷尺寸

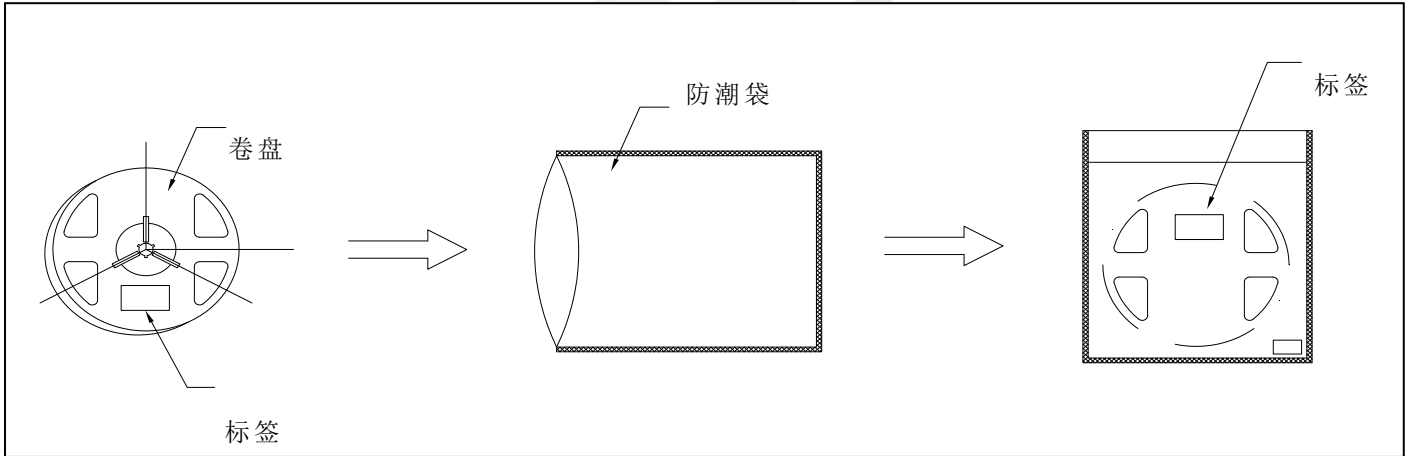
备：

：公差为±0.1，尺寸单位：。

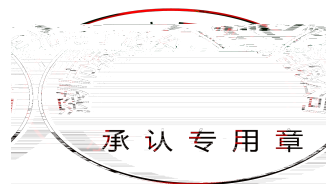
PART NO:		
SPEC NO:		
LOT NO		
BIN CODE:		
Φ:	XY:	
VF:	WLD:	
	QTY:	
	DATE:	

参
品名
号
参代
光
区
向压
代
产

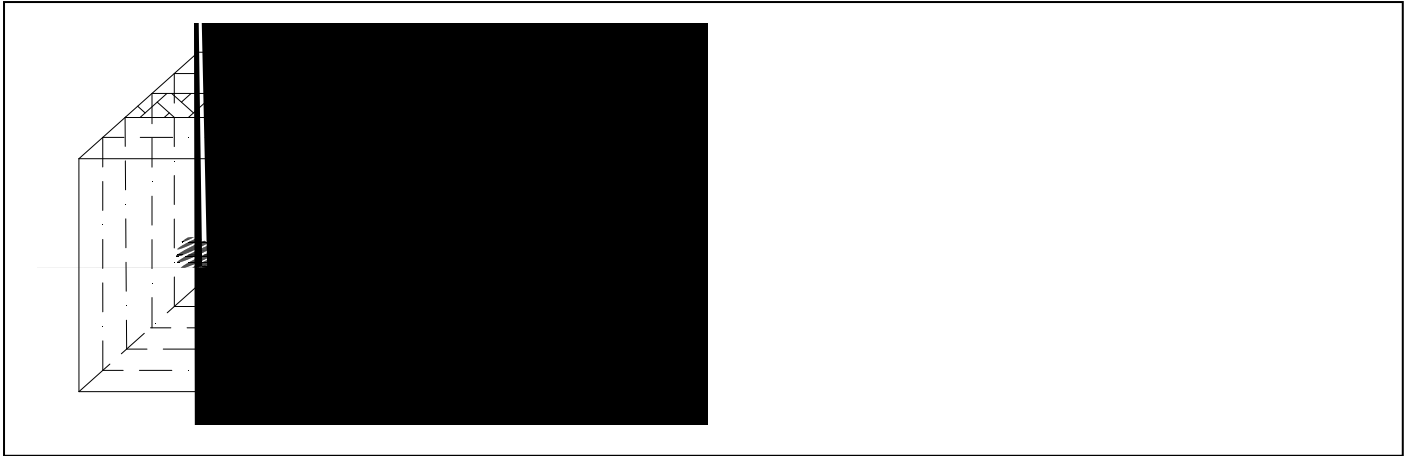
包



包



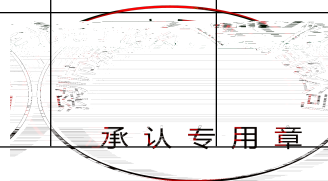
包



包  
信 及 件

信 及 件

	参 准	件			
回		°C			
度循		°C °C			
冷 冲击		°C °C			
保存		°C			
低 保存		°C			
常		°C			



## 失 判 定 准

失 判 定 准

	号	件	判定 准	
			小	大
向 压				
光				

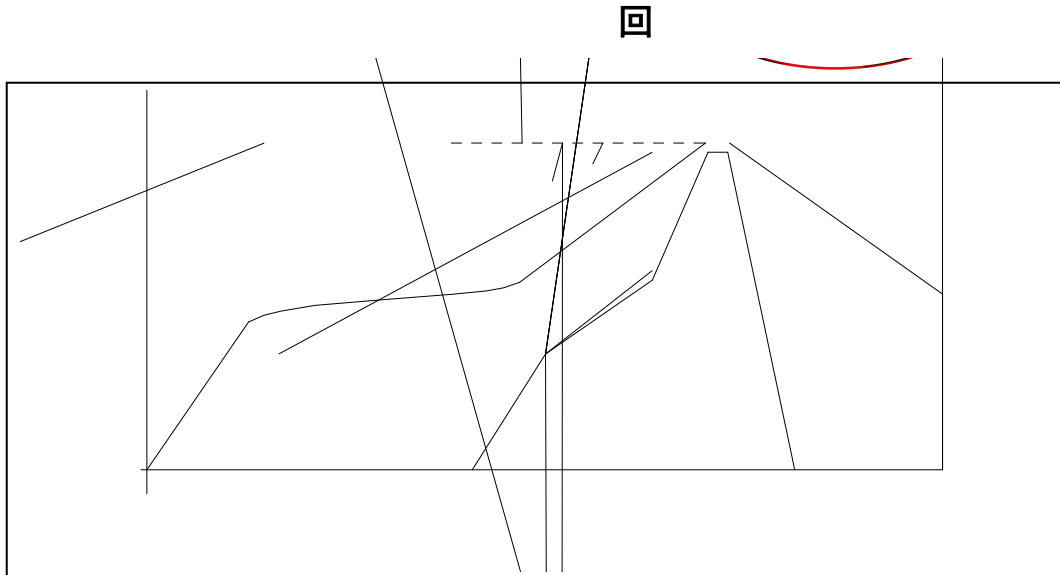
备 ：

上 下  
REFOND

以上可 基于 丰 实 平台单 / LED在 好 件  
下 。客 将LED应 于串、并 ， 估 、 压分 、 。

以上 仅为产品 典型值，只作为参 ，不作为任何应 件及应 式 保 。





回

参

平均升 度 ( )	
: 低 度	
: 度	
: ( )	
: 度	
:	多
峰值 分 度	
峰值分 度: ( )	多
。 与实 峰值 度	多
差 以内 保	
度	
升 峰值 度	多分

备：

回 不可以 两 ，两 回 如 24小 ，LED可 于吸  
坏。

当 ，不 在 受 力压 体  
。

.当 工 ， 度必 小于 $300^{\circ}\text{C}$ ， 不可 3  $^{\circ}\text{C}$ 。

工 只可 一 。

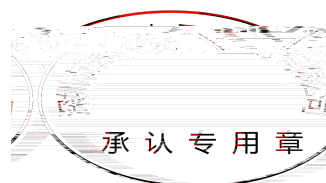
修

回 后不应 修复，当必 修复 ，必 使 双头 ， 且事先应 式会不  
会 坏LED 。

事

不 在弯 PCB 上， 之后，也不 弯 。

对 加外力，也不 动，回 后，不 剧冷却 式。  
回 之后冷却 中，不



产品使 事

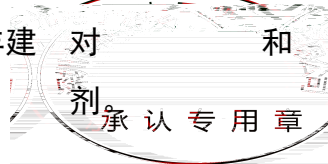
产品使 事

工作 境及与 LED 中 元 及化合 份不可 100PPM. 只  
一个建 , 不作任何品 保。

境及 套件 , 单一 元 含 为了 外 入LED内 以 LED 伤, 处  
与 元 含 必 小于 1500PPM. 只 一个建 , 不作任何品 保。



子及 件下, 会导 LED 变 , 应 套件中 发 会 到LED内 , 在 产 光  
。 丰反对使 任何对 LED 器件 可 害 严 光 , 前了 套件 够 免产 些  
了 仅仅怀 害。 对 定 和使 境, 丰建 对 和 容  
。在 LED 候, 不 使 产 发 体 剂 承认专用章



LED  
 不定大值，同，使保，否则，微小压变化将会引大  
 变化，可导产品。必保只在开启关候出向压变化，不  
 加反压，否则会坏LED。

容因为发和境  
 度变变，度升会低LED发光，影响发光，以在应充分  
 。

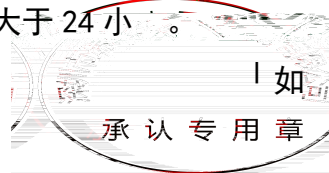
储存

		度	度	
储存	包前	$\leq$ °C	$\leq$	一年内
	包后	$\leq$ °C	$\leq$	小
		$\pm$ °C		$\geq$ 大于 小

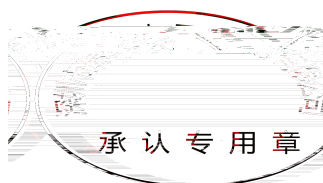
( )

，  
 ( ) °C 如干剂包失，产品不合以上  
 储存件，包后，件：60±5°C，大于24小。

，售人员协助处。



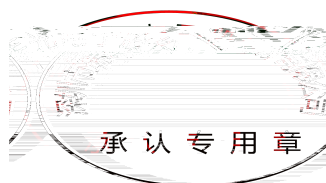
像其他 半导体 子器件一 ， LED 对 击 常 ，  
做好 。  
关 。 其它 事 参 丰







REFOND



产品 书以中 式书写, 冲 以中 为准。

---